

Индивидуальная Коррозионностойкая Корзина-Клетка Для Очистки Фотомасок Ptfе 6 Дюймов С Двумя Ручками

Артикул: PL-CP05



введение

Высокопроизводительные индивидуальные стойки для очистки фотомасок PTFE 6 дюймов с двумя ручками обеспечивают непревзойденную химическую стойкость для полупроводниковых и лабораторных мокрых процессов. Эти прочные корзины-клетки обеспечивают надежное удержание образцов, быстрый дренаж и очистку без загрязнений при работе с агрессивными кислотами и растворителями.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Очистка RCA в полупроводниковой промышленности	Полная устойчивость к окислителям и высокотемпературным кислотам исключает разрушение носителя.	
Травление фотомасок	Удержание 6-дюймовых фотомасок при удалении хрома или других светоблокирующих слоев с помощью агрессивных травителей.	Надежная фиксация предотвращает вибрацию маски, обеспечивая высокоточную передачу рисунка и отсутствие поверхностных царапин.
Текстурирование солнечных элементов	Процесс создания микропирамид на кремниевых поверхностях с использованием смесей KOH или HF/HNO ₃ для улучшения поглощения света.	Прочная конструкция с двумя ручками позволяет безопасно работать в крупносерийных промышленных условиях с глубокими ваннами.
MEMS и микрофлюидика	Очистка и травление стеклянных или кремниевых подложек, используемых при производстве микроэлектромеханических систем.	Чистота материала предотвращает попадание следовых примесей, которые могут нарушить функционирование микромасштабных устройств.
Лабораторная посуда для следового анализа	Удержание стаканов, крышек или мелких компонентов во время специализированной пероксидной очистки или замачивания.	Гарантированное отсутствие ионов металлов (безыонная конструкция) делает его эталонным решением для поддержки анализа ультраследовых элементов.
Подготовка проводящего стекла	Очистка стеклянных подложек с покрытием ITO или FTO для исследований OLED или перовскитных солнечных элементов.	Сетчатая конструкция обеспечивает полный контакт жидкости с проводящим слоем, защищая края подложки.
Мокрый химический проявление	Транспортировка экспонированных пластин, покрытых фоторезистом, через растворы проявителя в литографических процессах.	Химическая стабильность в различных органических проявителях обеспечивает стабильные результаты и нулевое взаимодействие с материалами.

Параметр	Детали спецификации (Модель: PL-CP05)
Основной материал	100% высокочистый первичный политетрафторэтилен (ПТФЭ)
Совместимость с подложками	Стандартные 6-дюймовые (152,4 мм) фотомаски, пластины или стекло
Конфигурация ручек	Усиленная опора с двумя ручками для сбалансированного вертикального подъема
Температурная устойчивость	-200 °C до +260 °C (-328 °F до +500 °F)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Параметр	Детали спецификации (Модель: PL-CP05)	
Химическая совместимость	Универсальная (Все кислоты, щелочи, органические растворители и растворы пираньи)	
Конфигурация пазов	Настраиваемые ширина паза, шаг и общая вместимость (стандарт 10/25 пазов)	
Конструкционные особенности	Обработанное на ЧПУ сетчатое основание для быстрого дренажа; скругленные точки контакта с образцом	
Обработка поверхности	Гладкая беспористая обработанная поверхность ПТФЭ (Низкое трение)	
Высота ручек	Настраивается под конкретную глубину очистной ванны	
Содержание металла	Ноль (Конструкция без металла)	